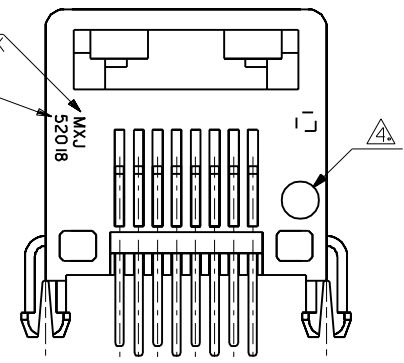
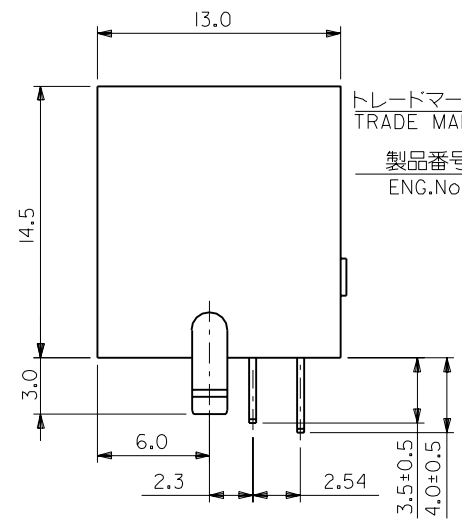
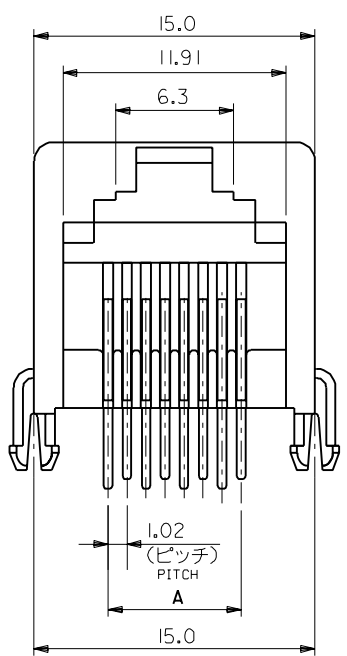


ENG. NO. SD-52018-8**5

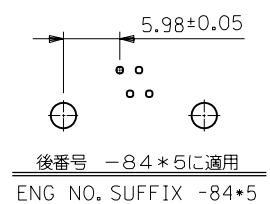
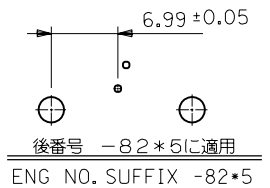
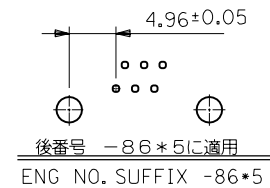
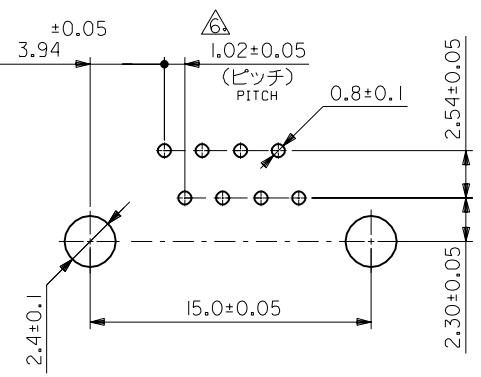
EDP NO. —

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ, 表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 半田メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN-LEAD 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0µmMIN.
 - 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- △ 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.
YELLOW: 0.1µmMIN. GREEN: 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.
ORANGE: 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
- △ 公差非累積
NON-ACCUMULATIVE



後番号 -88*5に適用
ENG. NO. SUFFIX -88*5

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

8	8	7.11	1.27	52018-8845
			0.76	-8835
			0.38	-8825
			0.1	-8815
	6	5.08	1.27	-8645
4	3.05	1.27	-8445	
2	1.02	1.27	52018-8245	
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚(µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 ENG. No.

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	EDP. NO.	REV
適用電線範囲 WIRE RANGE	---	ENG. NO.	B
被覆外径 INS. RANGE	---	SD-52018-8**5	
DRAWN BY: 89/10/30 CHK'D BY: 89/3/8 A. HIRAMOTO H. HIRAMOTO	DATE	TITLE 名称	
APP'D BY: 89/3/8 M. FUKUSHIMA	尺度 SCALE 4-1	MODULAR JACK HOUSING ASS'Y	

角度 ANGLE	±3°	B	変更 REVISED (JC60607)	8/96
30以上 OVER	+0.3	A	変更 REVISED (T90386)	89/2/18
10以上 30未満 UNDER	+0.25	O	新規作成 RELEASED	89/4/30
10未満 UNDER	+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. 日付 CHK. DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

ZF3E110J024J56201808.DGN:1

MXJ-8